



2026年2月期（第41期） 第3四半期 決算説明資料

2026年1月9日
ローツェ株式会社

証券コード：6323
<https://www.rorze.com/ir>

◆ 将来見通しに関する記述について

本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なく変更されることがあります。

◆ 本資料における表示方法について

数 値： 単位未満を切り捨て

比 率： 1円単位の金額で計算後、単位未満四捨五入

会計年度： 年度開始日の暦年表記（「2026年2月期」を「FY2025」または「FY'25」と表記）

会計期間： 連結・当社、国内および海外子会社の会計期間は次のとおり

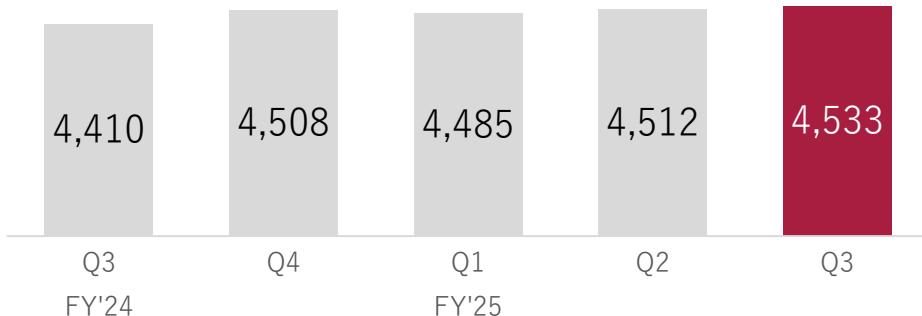
	Q1 (第1四半期)	Q2 (第2四半期)	Q3 (第3四半期)	Q4 (第4四半期)	通 期
連結・当社・国内子会社	3月～5月	6月～8月	9月～11月	12月～翌年2月	3月～翌年2月
海外子会社	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～12月

会社概要

RORZE

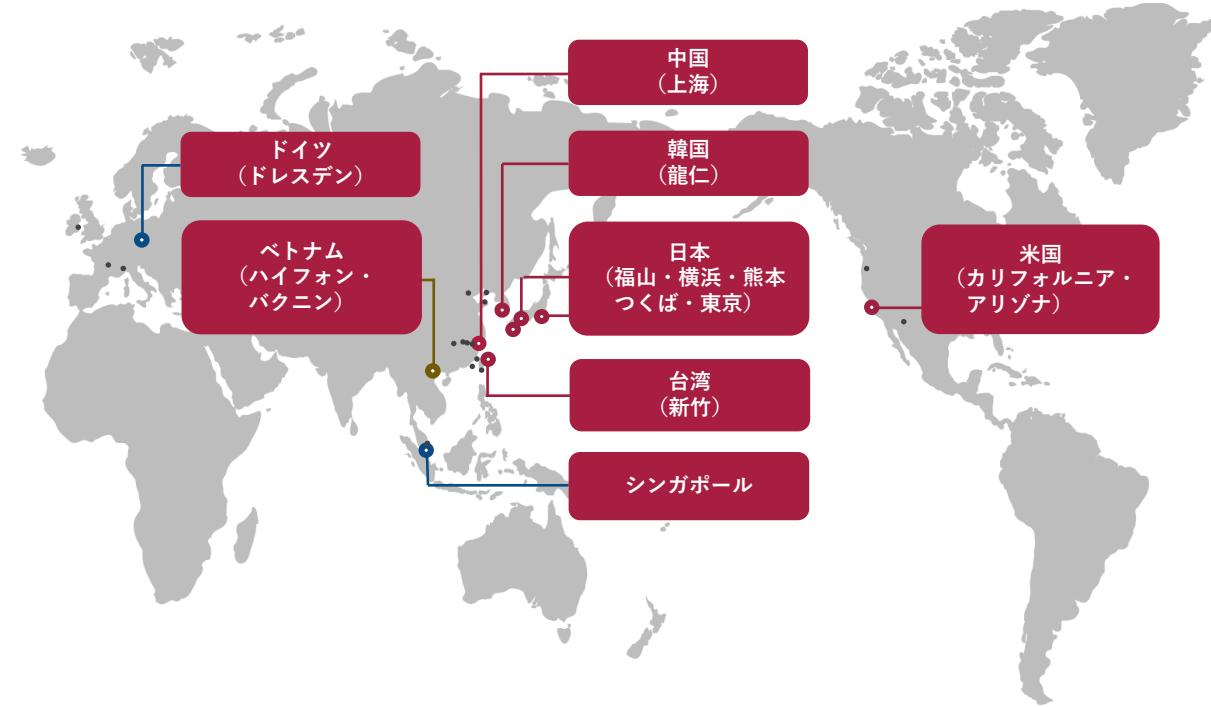
会 社 名	ローツェ株式会社 (英文名 ; RORZE CORPORATION)
上 場 市 場	東京証券取引所 プライム市場 (証券コード : 6323)
所 在 地	広島県福山市神辺町
設 立	1985年3月30日
資 本 金	982百万円
事 業 内 容	半導体・フラットパネルディスプレイ (FPD) ・ライフサイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売
従業員数 ※	連結：4,533名 当社：363名 (2025年11月末現在) 国内：福山・横浜・熊本・つくば・東京 海外：米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・中国・ドイツ・フランス
事 業 抱 点	

従業員数の推移（連結）※

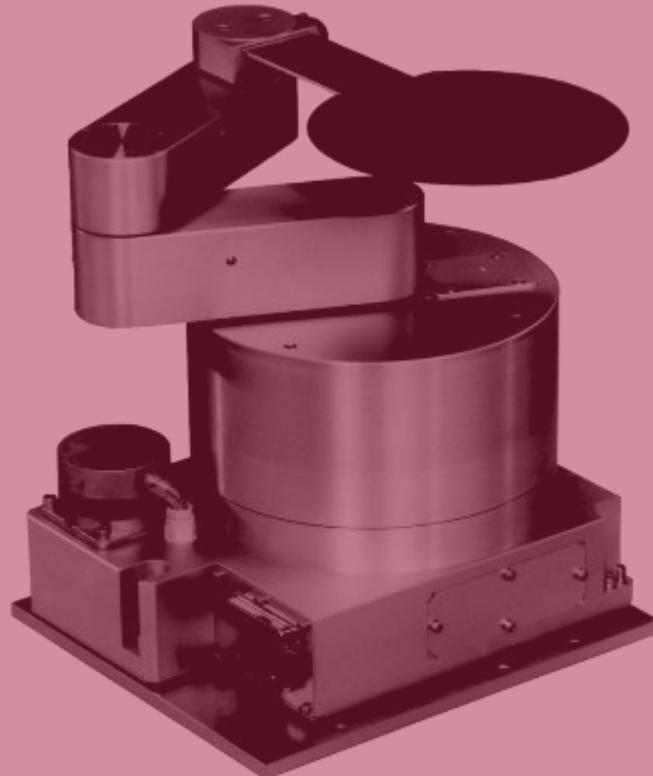


※当四半期より、臨時従業員および再雇用従業員の年間平均雇用人員を含めた人数に変更し、過去分も遡って更新しています。

グローバルネットワーク



- 開発・生産・営業・サポート
- 営業・サポート
- 開発・生産
- サポート



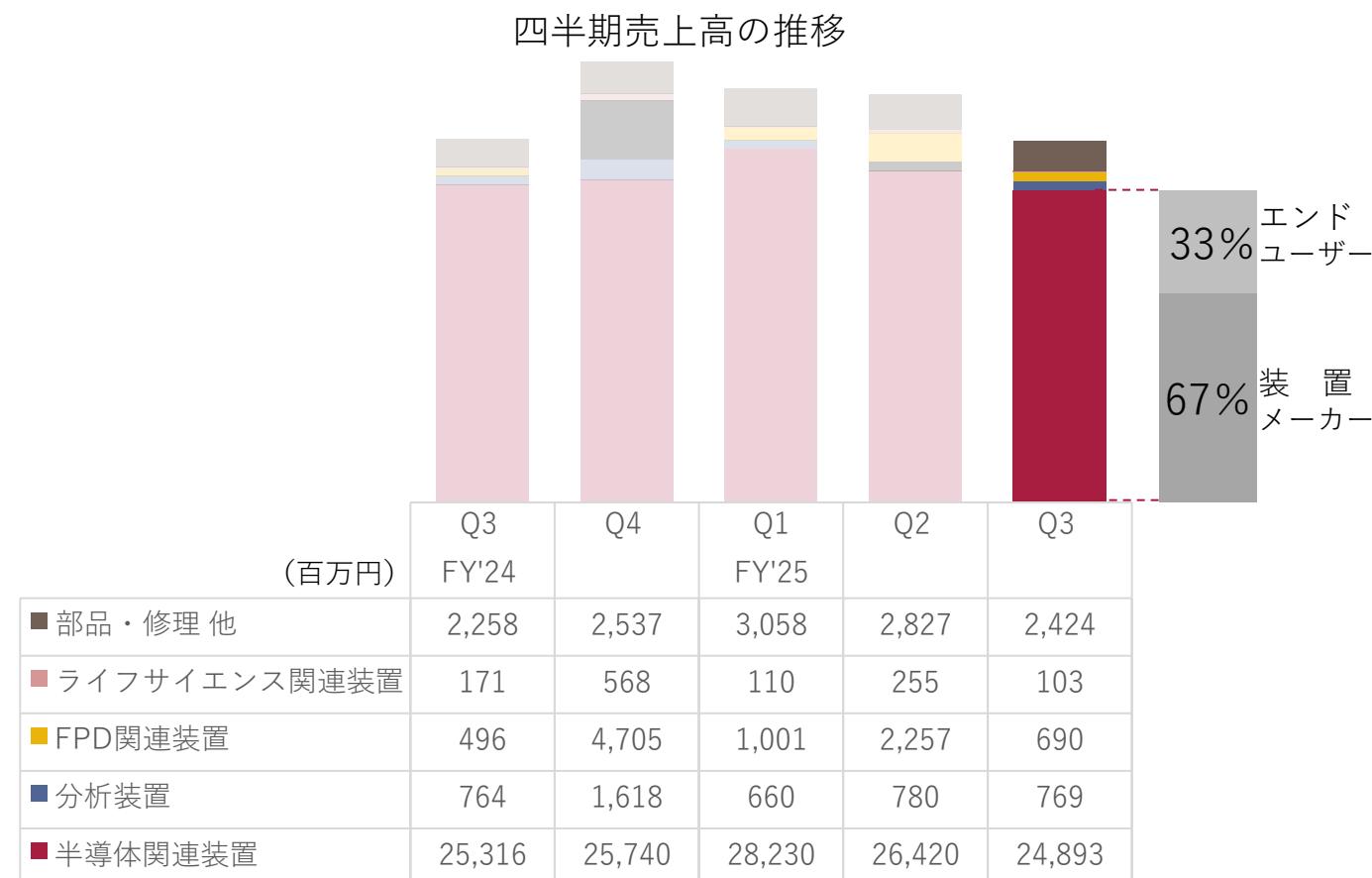
2026年2月期（第41期）
第3四半期(2025年3月～11月)
連結業績

業績ハイライト

RORZE

- 売上高は前年同期比6%増。四半期売上高は台湾主要顧客や中国装置メーカーが一時的に減少
- 営業利益は8%減。売上総利益は6%増加するも、前期Q3から連結対象の子会社関連費用計上により減少
- 経常利益は13%減。親子会社間貸付金等にかかる為替変動による営業外損益計上(前年同期比▲16億円)

	FY'25 Q3	FY'24 Q3	前年同期比
売上高	94,483	89,236	105.9%
半導体関連装置	79,544	76,628	103.8%
分析装置 ※	2,210	1,978	111.7%
FPD関連装置	3,949	3,888	101.6%
ライフサイエンス関連装置	469	506	92.7%
部品・修理 他 ※	8,310	6,234	133.3%
営業利益	23,532	25,593	91.9%
経常利益	23,375	26,762	87.3%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	17,465	19,708	88.6%
期中平均レート(円/USD)	148	150	—

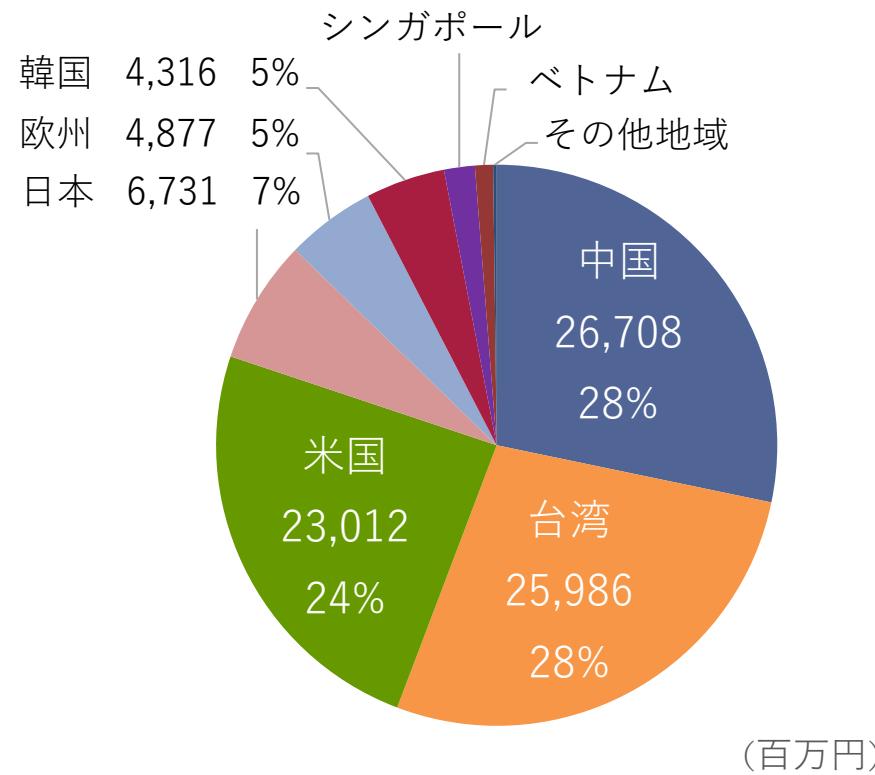


※ 当連結会計年度より製品別売上高のうち「部品・修理 他」の一部を「分析装置」へ含めて集計しており、前年度分は当該方法により集計した数値を記載しています。

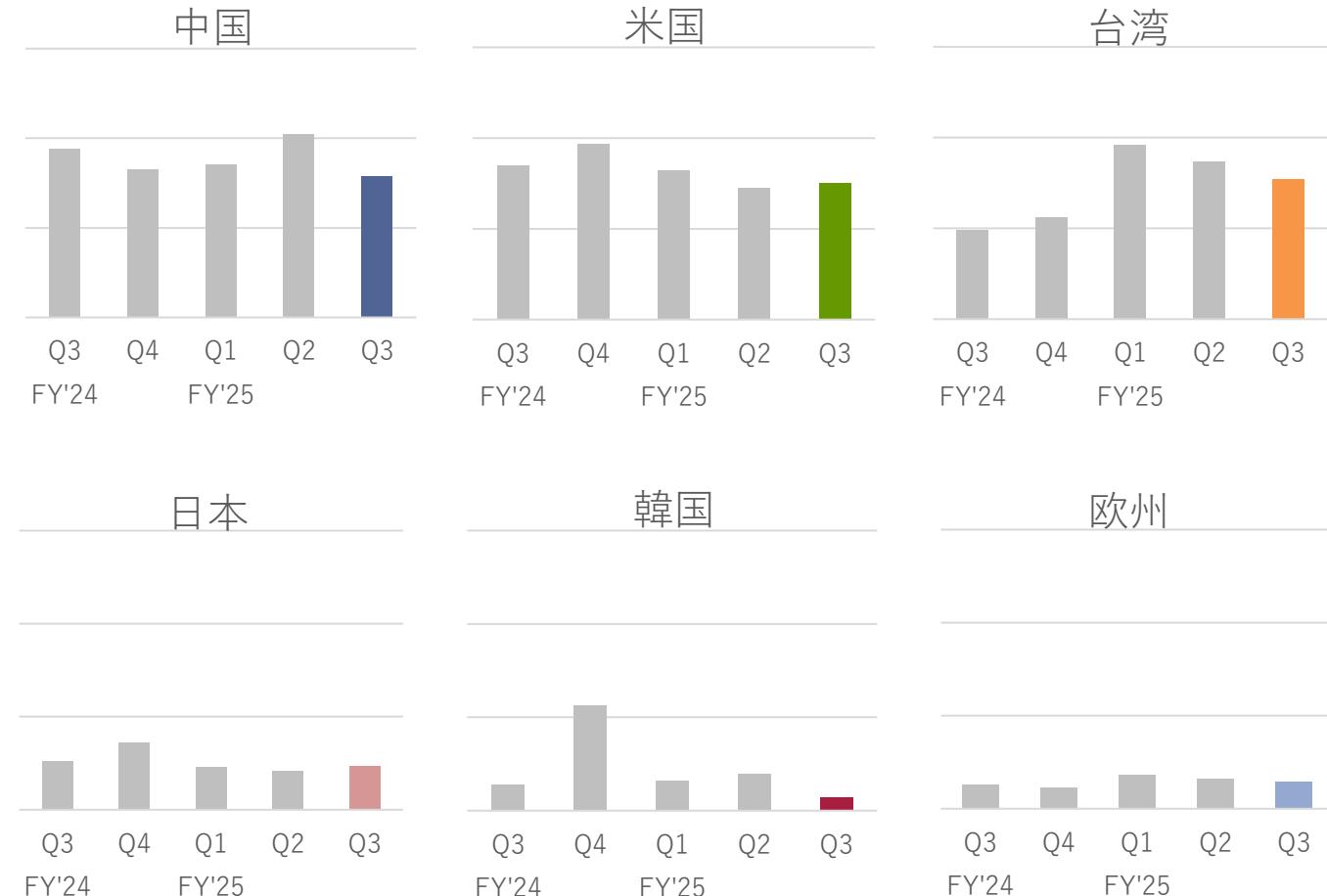
地域別売上高

RORZE

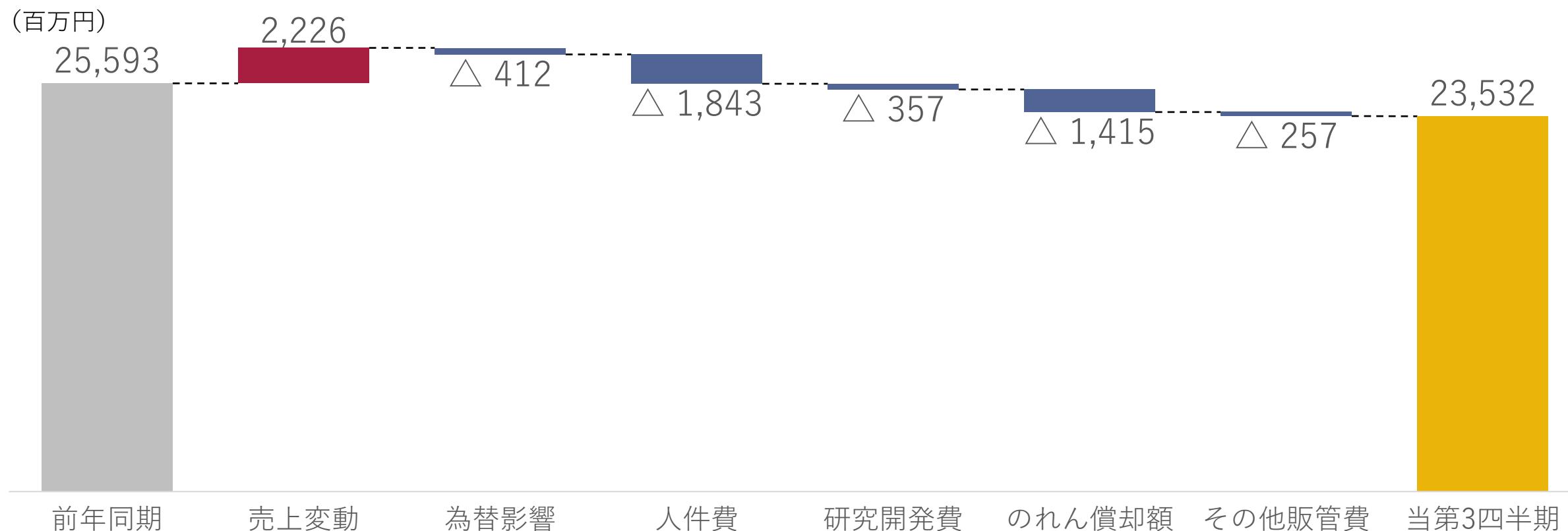
- 主要地域ごとの順位、構成比に変化なし
- 四半期売上高は、装置メーカー向けで米国が増加し中国が減少、台湾は増加局面が一巡し減少するも高水準



※ 「地域別売上高」は顧客企業の本社所在地別に集計



- 半導体関連装置を主として増収なるも、為替影響および子会社にかかる人件費・のれん償却等による販管費増加により営業減益



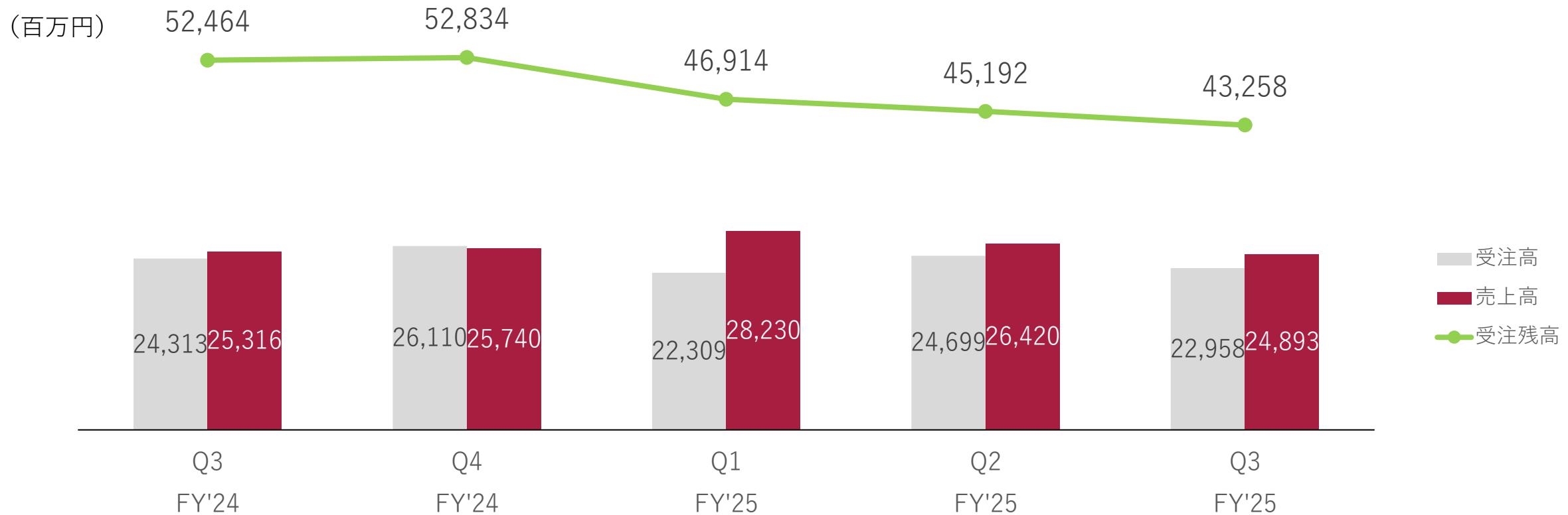
※ 連結営業利益に対するNanoverse社の影響額(百万円)：人件費1,385、研究開発費62、のれん償却額2,100、その他販管費1,105

受注高・売上高・受注残高の推移

RORZE

半導体関連装置

- 売上高は、中国装置メーカーおよび台湾ファウンドリ向けが減少、米国装置メーカー向けは増加
- 受注高は、台湾ファウンドリ向けが一時的減少で受注端境期、米国、韓国で受注増加

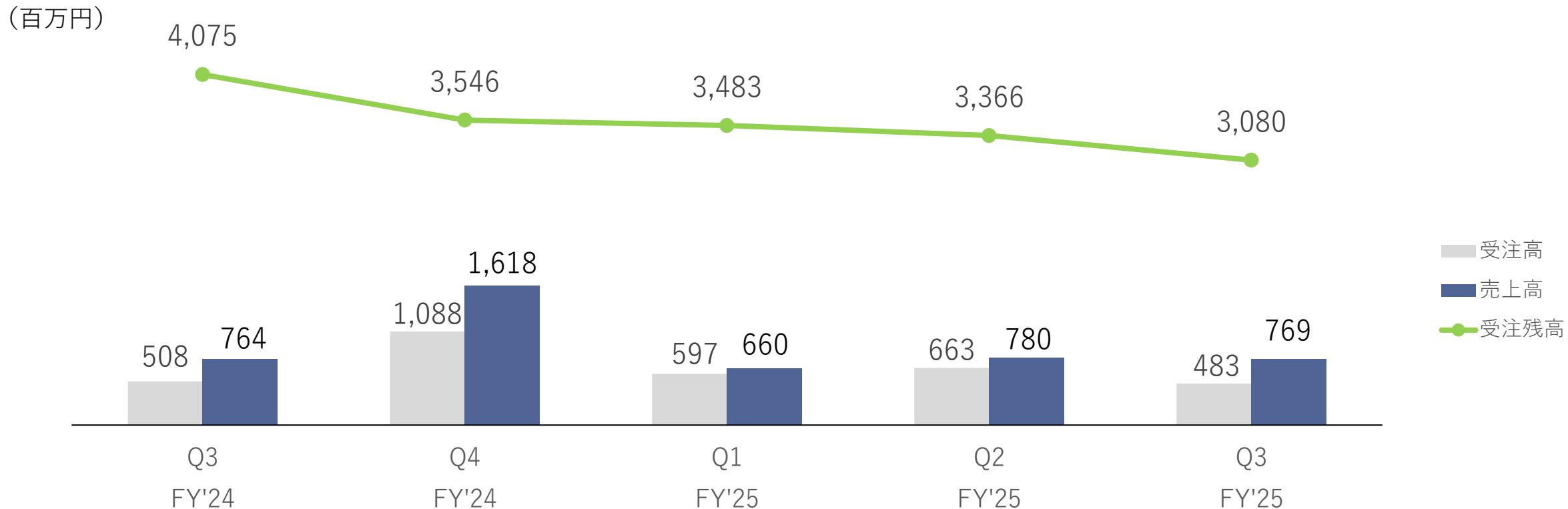


受注高・売上高・受注残高の推移

RORZE

分析装置

- 足元の事業環境が一段落する中、顧客の設備投資計画遅延の影響を受け受注時期が後ずれ
- 一昨年に発表した新レーザーアブレーション装置(Expert_LA)が、半導体先端プロセス向けに高評価拡大中、新規受注獲得に手応え



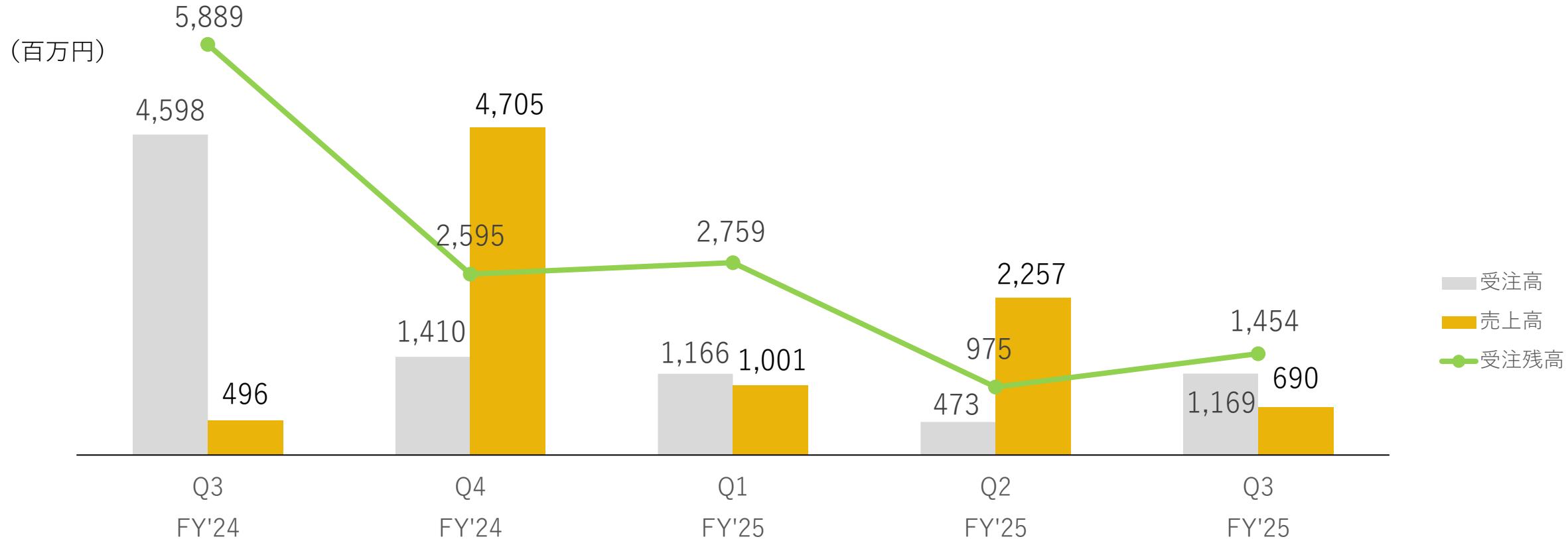
※ 当連結会計年度より製品別売上高のうち「部品・修理 他」の一部を「分析装置」へ含めて集計しており、前年度分は当該方法により集計した数値を記載しています。

受注高・売上高・受注残高の推移

RORZE

FPD関連装置

- 売上高は、装置搬入時期が翌四半期に変更されたため当四半期減少
- 受注高は、前期Q4以降装置納入進捗により新規受注が減少、当四半期は足元の受注確保により増加



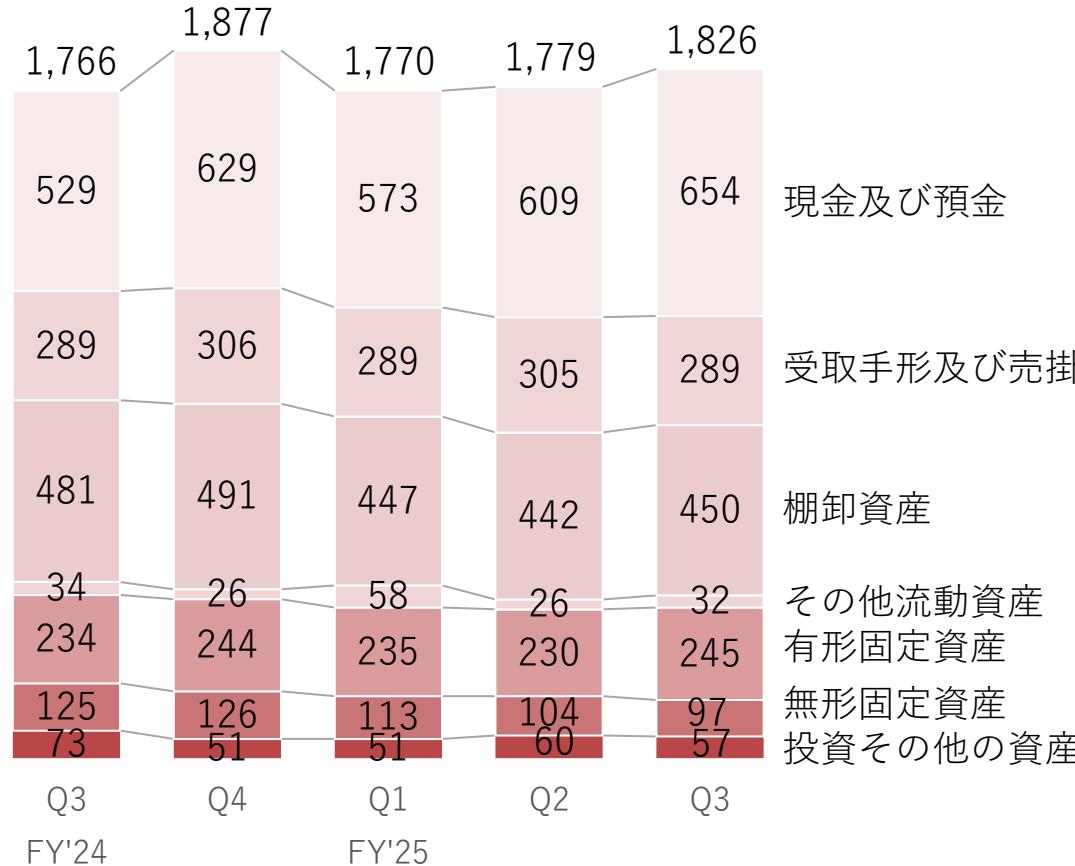
連結貸借対照表

RORZE

- 現金及び預金は、事業投資用の資金を確保しつつ、今期において有利子負債圧縮65億円、自己株式取得50億円(7月末完了)を実施

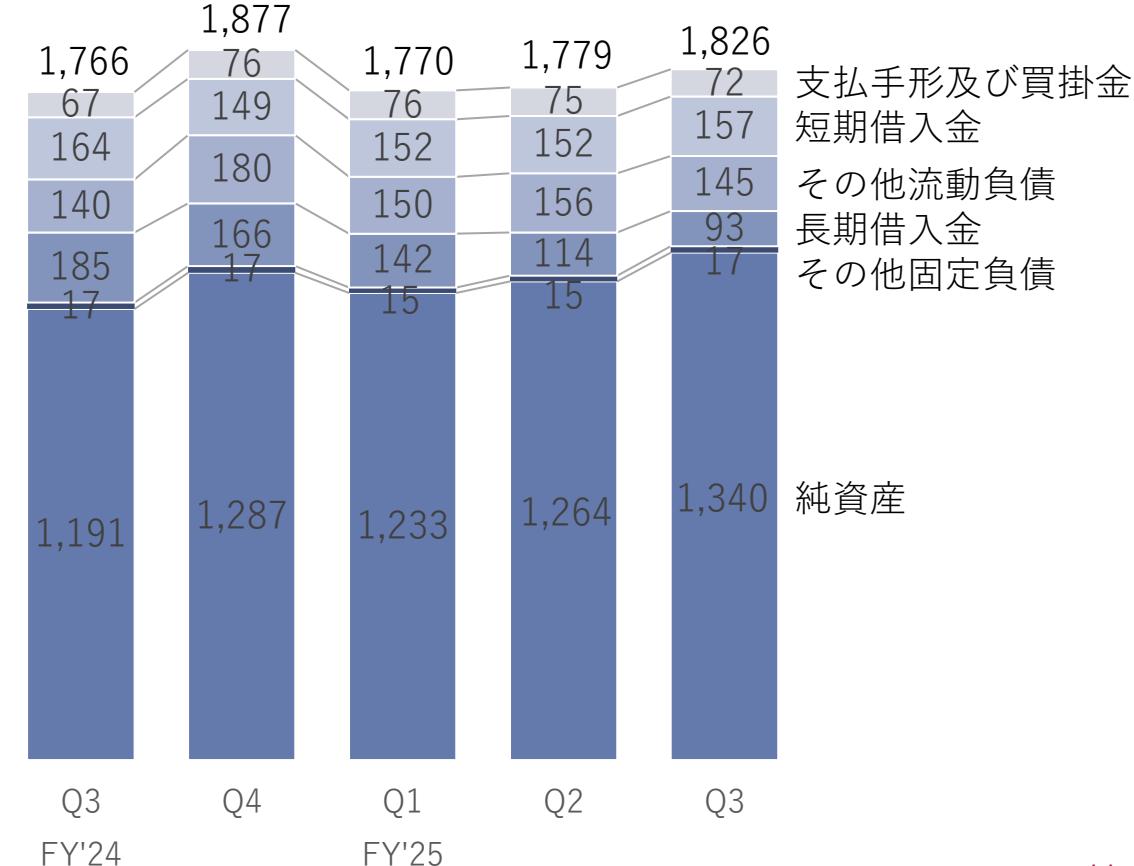
資産

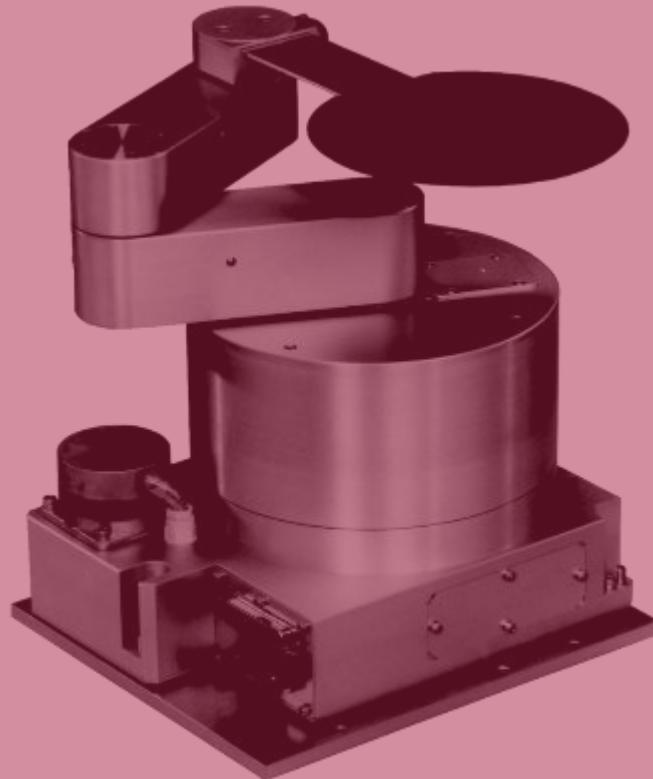
(億円)



負債・純資産

(億円)





**2026年2月期（第41期）
今後の見通し**

2026年2月期 業績予想に対する進捗

RORZE

- 通期連結業績予想の達成に向けて引き続き注力
- 生成AIの需要拡大に伴い、先端プロセス向けの新規設備投資は増加、拡大の見通し
- Q4以降来期に向けEFEMやウエハソータ等の主力搬送装置の受注、売上は増加を見込む

(百万円)

	FY'25 Q3実績	FY'25 通期予想	通期予想 進捗率(%)
売上高	94,483	128,190	73.7
半導体関連装置	79,544	106,893	74.4
分析装置	2,210	4,163	53.1
FPD関連装置	3,949	6,550	60.3
ライフサイエンス関連装置	469	1,590	29.5
部品・修理 他	8,310	8,992	92.4
営業利益	23,532	30,345	77.6
経常利益	23,375	30,618	76.3
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益	17,465	23,499	74.3



トピックス

Yield Engineering Systems社よりサプライヤアワード受賞

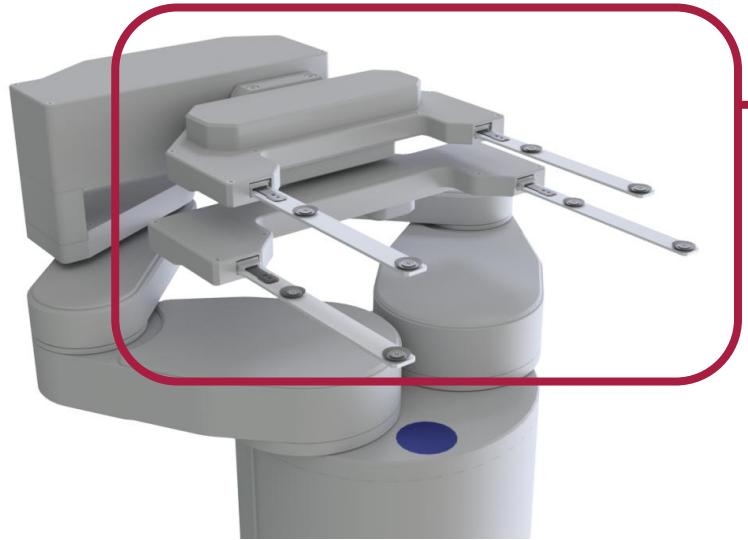
RORZE



米国子会社RORZE AUTOMATION, INC. が、半導体
製造工程における表面処理や熱処理、成膜装置など
を手掛ける米国Yield Engineering Systems社より
2025年度サプライヤアワードを受賞

Flap Wrist をSEMICON Japan 出展

RORZE



Flap Wrist フラップリスト (特許出願中)

- 大きく湾曲したウエハを吸着し、平坦化した上で搬送することによりクリーン搬送を可能にする
- 可動式真空吸着フィンガの4つの真空パッドで吸着することにより、フィンガがウエハの形状に追従し、通常のウエハのほか反ったウエハ、極薄のウエハなど3種類の半導体ウエハの搬送が可能
- 異なるウエハに合わせたハンドの持ち替えが不要
- ウエハを反転させて搬送することが可能



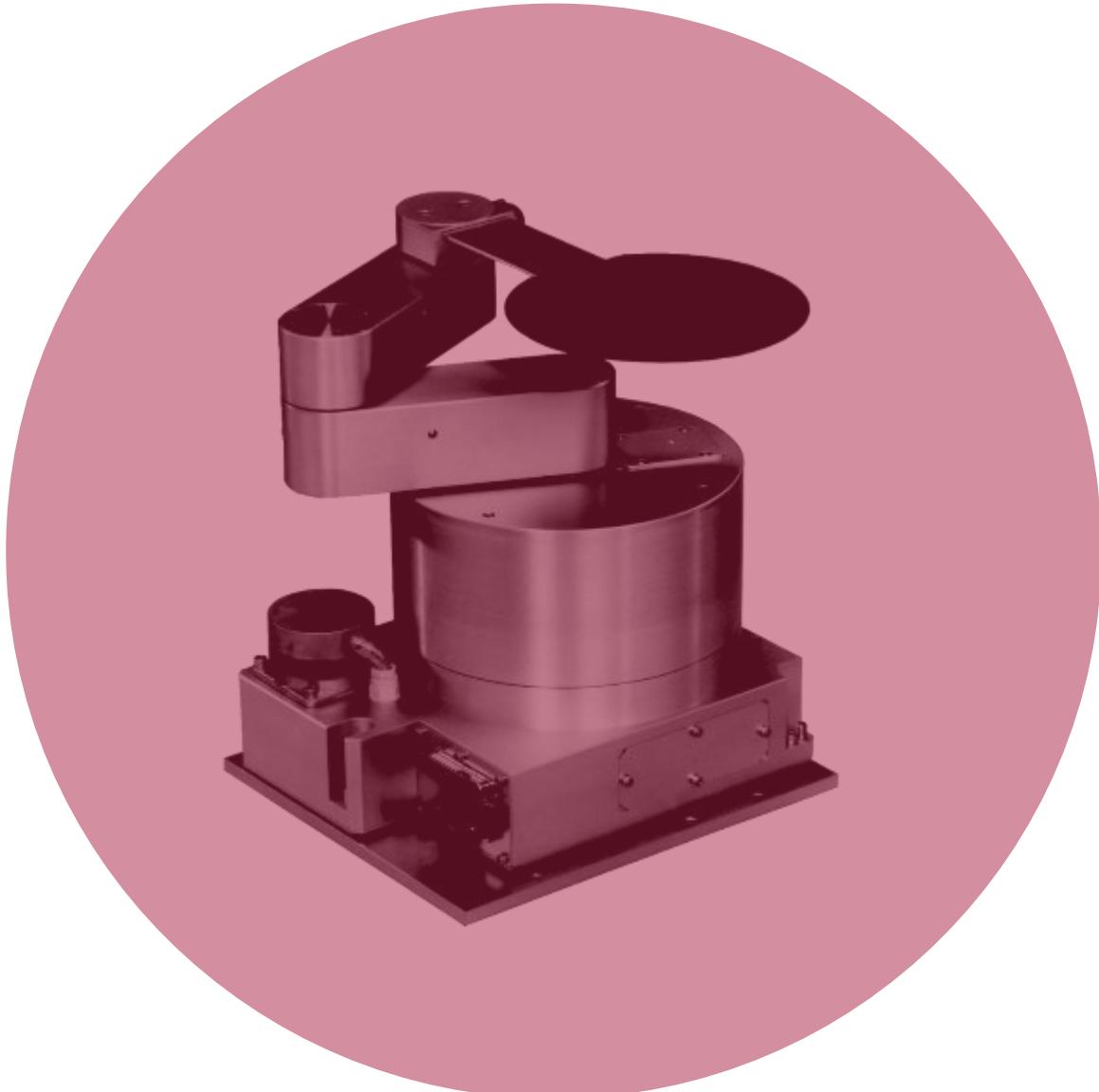


SEMICON Japan 2025 に出展

NVT 7700

レーザーシンギュレーションと計測の完全統合装置

- 独自のレーザーによる理想的レーザースクラバーとダイシング
- 業界トップクラスの高精度、高スループット
- マルチシャトルチップ[※]に対応
 - ※ 複数のチップを集積して1個のパッケージのICにすること
- チップ(ダイ)強度が業界トップクラス他社比較3倍
- 業界初3Dリアルタイム計測機能を装備



參考資料

半導体関連装置

RORZE

ユニット



大気用搬送ロボット



アライナ



ロードポート

システム



EFEM



真空プラットフォーム

システム



ウェハソーター



N2パージウェハストッカー

装置メーカー

プロセス装置
検査装置

エンドユーザー

デバイスマーカー
ウェハメーカー

RORZE

アドバンスドパッケージ用装置

RORZE

アドバンスドパッケージ

より小さいフットプリントで高いデバイス密度と機能拡張を実現できるようにチップレットを接続する方法

■PCB(プリント基板)上でのパッケージング

前工程

1 ウエハで1種類のチップ

これまでのローツェ搬送装置の市場

ローツェの搬送装置が必要な新市場が拡大（前工程 + 中工程）

後工程

1 パッケージで1種類のチップ

PCB基板上にマウンターでパッケージング
(各半導体間はPCB基板を通じて通信)

■シリコンウェハ上でのパッケージング

中工程

後工程のパッケージングをする代わりに、
・ウェハを薄くしてシリコンを貫通する通信
用の豊穴形成 (TSV : Through Silicon Via)
・インターポーラ (※) 上で複数のウェハを
3Dに積層する

- アドバンスドパッケージ用装置
 - Tape Frame Sorter
 - PLP EFEMなど

※インターポーラ： 貫通電極によって表裏の回路の導通をとり中継する基板
(シリコンインターポーラ、ガラスインターポーラ、有機インターポーラ)

アドバンスドパッケージ用装置

RORZE



PLP用EFEM



Tape Frame用ソーター



分析装置

RORZE

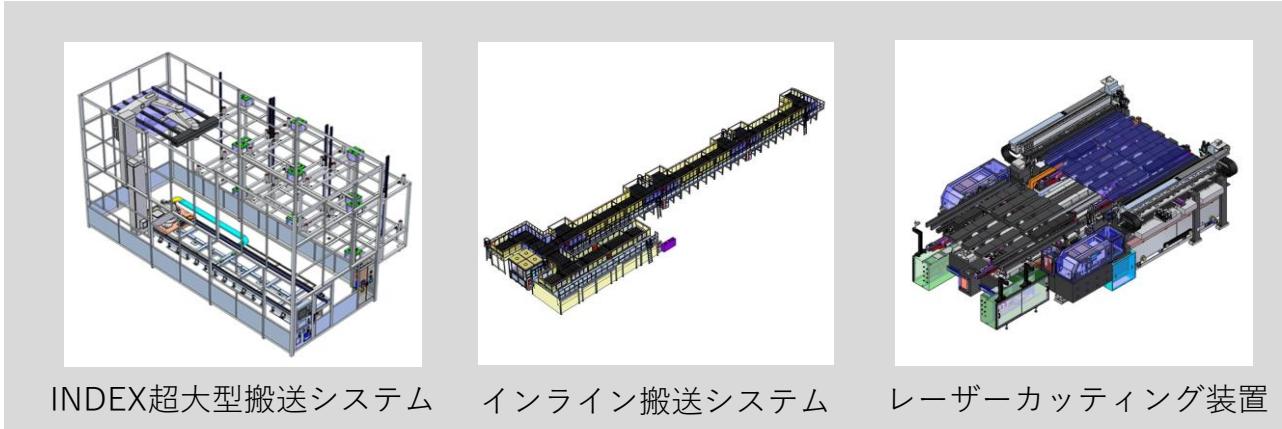


半導体業界
製造装置メーカー
エンドユーザー
デバイスマーカー¹
ウエハメーカー²

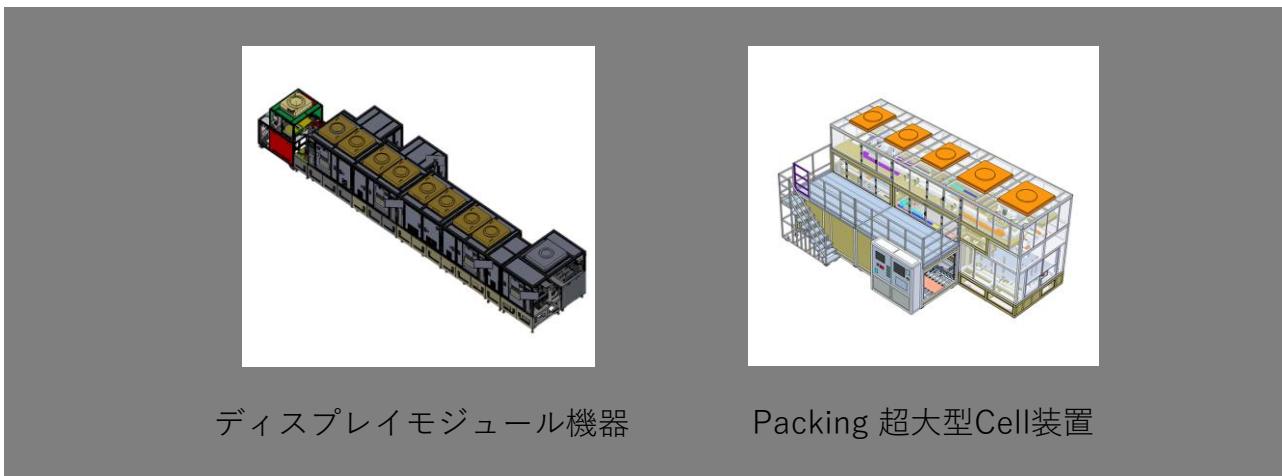
半導体業界以外
研究機関
環境計測機器
化学薬品メーカー
など

FPD関連装置

RORZE



前工程：
FPDメーカー
FPD用ガラスメーカー



後工程：
FPDメーカー

ライフサイエンス関連装置

RORZE

RORZE
Lifescience



インキュベータ
SCALE48



自動培地交換機能 & 細胞観察
機能付きCO₂インキュベータ
CellKeeper® II 48Plus



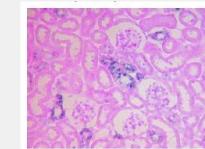
モバイルロボット



全自動培地交換システム
CellFarm(L)-360™



スケジューリング ソフトウェア
Green Button Go™
※
(※Biosero社製)



試験受託(細胞染色)
GenoStaff
ジェノスタッフ株式会社



大学・製薬企業等
研究機関
再生医療関連企業

RORZE